

证券代码：688233

证券简称：神工股份

公告编号：2026-027

**锦州神工半导体股份有限公司**  
**关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票不存在直接**  
**或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资**  
**助或补偿的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 13 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

根据相关要求，现就本次发行过程中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：

公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿的情形。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日